Температурная эволюция гистерезисной особенности на вольт-амперной характеристике поликристаллического высокотемпературного сверхпроводника структуры 1-2-3

© М.И. Петров*, Д.А. Балаев*, Д.М. Гохфельд*,**, К.А. Шайхутдинов*, К.С. Александров*

 * Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения Российской академии наук, 660036 Красноярск, Россия
** Сибирская аэрокосмическая академия им. М.Ф. Решетнёва, 660014 Красноярск, Россия

E-mail: smp@iph.krasnoyarsk.su

(Поступила в Редакцию 20 июля 2001 г. В окончательной редакции 1 ноября 2001 г.)

Изучена температурная эволюция вольт-амперной характеристики (ВАХ) контакта типа "break junction" с непосредственной проводимостью на поликристаллическом ВТСП системы Y–Ba–Cu–O. Экспериментальные ВАХ, обладающие гистерезисной особенностью, хорошо описываются в рамках теории Кюммеля– Никольского для S-N-S-контакта (S — сверхпроводник, N — нормальный металл), рассматривающей андреевское отражение квазичастиц на N-S-поверхностях раздела. Показано, что вид ВАХ, существование и форма гистерезиса определяются соотношением числа "длинных" и "коротких" межкристаллитных границ в исследуемом поликристалле. Хорошее совпадение рассчитанных и экспериментальных ВАХ позволило оценить эффективную протяженность "естественных" межкристаллитных границ в поликристаллическом ВТСП. Подобная оценка проведена на основании экспериментальной температурной зависимости критического тока исследуемого образца.

Работа поддержана грантом Шестого конкурса-экспертизы молодежных проектов РАН, 1999 г. (грант № 55) и частично поддержана Красноярским краевым фондом науки (грант 10F162M).

Объемные поликристаллические ВТСП обладают существенно меньшей токонесущей способностью, чем монокристаллы и тонкие пленки. Общеизвестно, что основным лимитирующим фактором являются межкристаллитные границы, наличие которых приводит к реализации хаотической сети слабых связей S-N-S (S — сверхпроводник, N — нормальный металл) в поликристалле. Распределение геометрических параметров отдельных слабых связей в такой сети подчиняется некой функции распределения, определяемой технологией синтеза поликристаллов.

Переходы на микротрещинах ("break junction") активно изучались в первые годы после открытия ВТСП. Однако до сих пор они остаются привлекательными объектами для исследования [1], поскольку на них можно изучать как туннельные контакты, так и контакты с непосредственной (металлической) проводимостью. Образование микротрещины в объемном ВТСП-образце приводит в случае контакта с непосредственной проводимостью к уменьшению эффективной площади поперечного сечения. Плотность тока в районе разлома гораздо выше плотности тока во всем объеме образца, поэтому слабые связи в районе разлома первыми переходят в резистивное состояние и определяют критический ток и вольт-амперную характеристику (ВАХ) до того момента, пока не начинается разрушение сверхпроводимости в объеме образца. Следовательно, резистивное состояние контакта типа "break junction" будет определяться суперпозицией конечного числа слабых связей. При этом появляется возможность провести измерения

ВАХ переходов на "естественных" межкристаллитных границах в широкой области температур в диапазоне плотностей тока, много бо́льших критической, практически исключив влияние саморазогрева, что крайне затруднительно сделать на объемных ВТСП-образцах.

Для описания экспериментально наблюдаемых ВАХ S-N-S-переходов джозефсоновского типа часто используется модель RSJ (Resistive Shunted Junction) [2] либо ее модификации [3,4]. Но данная модель представляет собой лишь эквивалентный электрический контур и, как указывают авторы в работах [2,5,6], не отражает квантовых физических процессов транспорта носителей в S-N-S-переходе.

В S-N-S-контакте транспорт носителей определяется такими физическими процессами, как туннелирование, эффект близости и андреевское отражение [7]. Начиная с работ Артеменко, Волкова, Зайцева [8,9] было создано несколько моделей, отдающих главную роль в формировании ВАХ андреевскому отражению. В пионерских работах [8,9] рассчитывались ВАХ микромостиков лишь в предельных случаях — вблизи Т_с и при напряжениях на контакте, много бо́льших энерегетической щели сверхпроводника. Авторы [10] описали ВАХ точечного контакта S-N и микросужения, при этом вид ВАХ определяется прозрачностью барьера. Теория описывает избыточный ток и аркообразные особенности BAX (subharmonic gap structure), но не описывает отрицательного дифференциального сопротивления (ОДС). В эксперименте ОДС проявляется в режиме заданного стабильного тока как гистерезис на ВАХ [11]. В ряде

работ рассматриваются ВАХ S-N-S-контактов в различных приближениях (см., например, [12–14]), однако в рассчитанных по этим моделям ВАХ отсутствуют участки с ОДС.

По нашему мнению, в настоящее время наиболее привлекательной теорией, описывающей ВАХ S-N-Sструктур в широком диапазоне длин свободного пробега носителей в *N*-прослойке (*l*) и геометрических протяженностей *N*-прослойки (2*a*), является теория Кюммеля-Никольского [15]. Эта теория учитывает вклад в ток от андреевских отражений в *S*-*N*-*S*-переходе. В рамках [15] предсказывается существование ОДС в "чистых" (l > 2a [11]) S - N - S-структурах. Также эта теория описывает избыточный ток и щелевые особенности при напряжениях, кратных значению энергетической щели Д. Теория [15] была успешно применена для описания некоторых результатов, полученных на S-N-Sконтактах на низкотемпературных сверхпроводниках [6]. Как указывалось авторами работ [15-17], в рамках этой теории можно интерпретировать гистерезис, наблюдаемый на ВАХ слабосвязанных ВТСП.

В [18] было показано, что упрощенный вариант теории Кюммеля–Никольского [5] удовлетворительно описывает экспериментальные ВАХ композитов $Y_{0.75}Lu_{0.25}Ba_2Cu_3O_7 + BaPb_{1-x}Sn_xO_3$ (x = 0, 0.1), измеренные при 4.2 К. В этих композитах нормальный металл BaPb_{1-x}Sn_xO₃ формирует искусственные металлические границы между ВТСП-кристаллитами. При x = 0 в композитах реализуется "чистый" предел, а при x = 0.1— эффективно "грязный" (l < 2a [11]) предел.

Цель настоящей работы — показать, что теория [15] применима не только к сети слабых связей с искусственно созданными металлическими межкристаллитными границами [18], но и к ВАХ на поликристаллитах с "естественными" межкристаллитными границами в ВТСП.

В данной работе мы провели измерения ВАХ с гистерезисной особенностью переходов типа "break junction" с непосредственной проводимостью в области температур 4.2–95 К. Полученные результаты удовлетворительно описываются в рамках теории [15] в предположении, что переходы с различной геометрической протяженностью соединены последовательно.

1. Эксперимент

В работе использовалась стандартная керамическая технология приготовления ВТСП $Y_{0.75}Lu_{0.25}Ba_2Cu_3O_7$. Время окончательного обжига составило 40 h при 910°С. На дебаеграмме наблюдаются только рефлексы, соответствующие структуре 1-2-3. Температура сверхпроводящего перехода T_c , полученная из магнитных измерений, и температура начала резистивного перехода совпадают и равны 93.5 К.

Из синтезированных таблеток выпиливались образцы с типичным размером 2 × 2 × 10 mm. Образец приклеивался к сапфировой подложке. Центральная часть образца сошлифовывалась до сечения $S \sim 0.2 \times 1 \,\mathrm{mm}$. При такой величине S значение критического тока при 4.2 К составляет $\sim 2 A$ (1000 A/cm²). Дальнейшее контролируемое уменьшение S при неизбежных механических напряжениях на токовых и потенциальных контактах крайне затруднительно. Для получения контакта типа "break junction" образец с указанным значением S вместе с подложкой изгибался с помощью винтов на прижимных токовых контактах, что приводило к микротрещине в части образца между потенциальными контактами. При этом возникал либо контакт туннельного типа (сопротивление $R > 10 \Omega$), либо контакт с непосредственной проводимостью ($R < 10 \,\Omega$). При $R \sim 1-2\Omega$ образцы обладают критическим током $J_c \sim 1 - 10 \,\mathrm{mA}$ при 4.2 K, что соответствует уменьшению S в $\sim 10^2 - 10^3$ раз. Отметим, что при термоциклировании от 4.2 до 100 К форма ВАХ образцов полностью сохранялась, но при термоциклировании до комнатной температуры *R* увеличивалось и контакт становился контактом туннельного типа.

Во время измерений образцы находились в гелиевой теплообменной атмосфере. Измерения ВАХ проводились в стационарных условиях в режиме заданного тока. Относительно низкие величины транспортного тока (до 150 mA) и падения напряжения на образце (до ~100 mV) позволили исключить влияние саморазогрева [19]. Критический ток определялся из ВАХ по критерию 1 μ V [20].

2. Результаты и обсуждение

На рис. 1 и 2, а приведены типичные примеры экспериментальных ВАХ при 4.2 К. Они характеризуются наличием критического тока, участком с нелинейной зависимостью U(I) и последующим скачкообразным увеличением U (в некоторых случаях неоднократным), сопровождающимся гистерезисом. В области больших значений I и U зависимость U(I) близка к линейной, ее экстраполяция к значению U = 0 дает величину избыточного тока I_{ex} , существование которого подтверждает металлический характер проводимости получившихся контактов [10].

Выражение для тока от андреевских отражений *S*-*N*-*S*-контакта в теории [15] имеет следующий вид (обозначения совпадают с использованными в [15]):

$$j = C \sum_{k} \sum_{n=1}^{\infty} P_N(E_k) \Big\{ [f(E_k)k_e - (1 - f(E_k))k_h] \\ \times \exp(-((2na - a + b)/l)) (|A_n^-|^2 - |A_n^+|^2) \Big\}.$$
(1)

В этой формуле $f(E_k)$ — фермиевская функция распределения квазичастиц по энергиям, P_N — вероятность нахождения квазичастицы в N— области, $A_n^+(E)$, $A_n^-(E)$ — вероятности *n*-го андреевского отражения для дырок (+) и электронов (-), *b* — стартовая позиция,



10 0 2040 60 80 100 120 I, mA

Рис. 1. Экспериментальная ВАХ при T = 4.2 К одного из образцов.

с которой квазичастицы начинают движение при начале действия напряженности электрического поля в *N*-прослойке, *n* — число андреевских отражений, *C* константа, определенная в работе [15]. При вычислениях нами использовалась плотность состояний носителей тока в ВТСП [21].

60

50

40

∩, mV 0

20

0

Теория описывает ВАХ S-N-S-контактов с вышеперечисленными характерными особенностями, исключая диапазон вблизи $U \approx 0$, поскольку вычисление критического тока является отдельной задачей [7].

Пример теоретической ВАХ приведен на рис. 2, b. Видно, что подобная теоретическая зависимость не может описать экспериментальные ВАХ, показанные на рис. 1, 2, а, на которых гистерезис наблюдается при больших величинах напряжения U. С другой стороны, множественный гистерезис, проявляющийся на некоторых ВАХ (рис. 1), свидетельствует о том, что зависимость U(I) определяется суперпозицией ВАХ нескольких контактов с различными параметрами. Подобный вывод был сделан для точечного ВТСП-контакта при изучении влияния излучения на форму BAX [22].

Мы обрабатывали экспериментальную ВАХ, приведенную на рис. 2, а, используя следующее выражение:

$$U(I) = \sum_{i} V_i U_i(I, 2a_i), \qquad (2)$$

где $U_i(I, 2a_i)$ — ВАХ S-N-S-переходов с различными значениями 2a, опредедяемыми выражением (1); V_i —

весовые коэффициенты, которые показывают степень влияния контакта с данным значением 2а на результирующую суперпозиционную ВАХ (очевидная нормировка $\sum_{i} V_i = 1$).

Оказалось, что использование уже двух слагаемых в сумме (2) хорошо описывает эксперимент. Наилучшее согласие было достигнуто при значениях $2a_1/l = 0.15$, $V_1 = 0.34, \ 2a_2/l = 0.5, \ V_2 = 0.66.$ На рис. 2, b показаны теоретические ВАХ для этих контактов (по отдельности), а на рис. 2, а приведена их суперпозиция. Видно, что суперпозиционная расчетная зависимость хорошо совпадает с экспериментальной ВАХ, включая участок с гистерезисом, но, как было указано выше, участок экспериментальной зависимости U(I) в диапазоне значений U вблизи нуля не описывается теорией [15].

На рис. 3, a в координатах (T, I, U) показаны экспериментальные ВАХ одного из образцов (того же, что и на рис. 2, a). На рис. 3, b в тех же координатах представлена температурная эволюция суперпозиционной ВАХ, приведенной на рис. 2, b. Варьируемым параметром была только температурная зависимость энергетической щели, взятая нами из теории БКШ. Теория [15] хорошо описывает уменьшение площади гистерезиса и его исчезновение при повышении температуры. При температурах выше 4.2 К расхождение теоретических и экспериментальных зависимостей U(I) становится более заметным, однако разница между этими зависимостями не превышает 9%. Важно отметить, что эксперимен-



Рис. 2. Экспериментальная ВАХ при 4.2 К одного из образцов (точки). Сплошные кривые: a — результирующая суперпозиционная кривая при $V_1 = 0.34$ и $V_2 = 0.66$, рассчитанная по (2), b — теоретические зависимости ВАХ S-N-S-переходов с параметрами $2a_1/l = 0.15$, $2a_2/l = 0.5$, рассчитанные по (1).

тальные точки скачкообразного изменения напряжения описываются теорией достаточно хорошо. Подобное удовлетворительное согласие в широкой области температур было достигнуто и для других исследованных образцов.

Зная длину свободного пробега носителей, из условия описания экспериментальных ВАХ можно оценить величины протяженности межкристаллитных границ в исследуемом ВТСП. Если для l взять величину ~ 20 Å, приведенную в работе [23] для системы Y–Ba–Cu–O, то получим $2a_1 = 3$ Å и $2a_2 = 10$ Å. Эти значения согласуются с данными для "естественных" межкристаллитных границ в поликристаллическом Y–Ba–Cu–O [24] и бикристалле [25]. Полученные величины коэффициентов $V_1 = 0.34$ и $V_2 = 0.66$ могут быть интерпретированы следующим образом: ВАХ определяется как минимум



Рис. 3. Температурная эволюция ВАХ, приведенных на рис. 2. *а* — эксперимент, *b* — теория.

тремя последовательно соединенными контактами, протяженность одного из которых равна 3 Å, а протяженности двух других составляют по 10 Å.

Протяженность межкристаллитных границ может быть оценена и из экспериментальной температурной зависимости критического тока [24–27]. Экспериментальная зависимость $J_c(T)$ исследуемого образца представлена на рис. 4. В ряде теоретических работ [7,28,29] исследовалась зависимость критического тока слабой связи с непосредственной проводимостью от температуры и толщины металлической прослойки. Теоретические кривые из работ [7,28], дающих сходные результаты, достаточно хорошо согласуются с нашими экспериментальными данными. В этой работе для описания $J_c(T)$ использована ранняя, более простая, теория [28]. На рис. 4 представлены теоретические зависимости [28]. В широкой области температур наблюдается хорошее согласие экспериментальной кривой $J_c(T)$ с теоретическими зависимостями для слабой связи с толщиной *N*-прослойки $2a = 0.3 - 0.4\xi_N$, где ξ_N — длина когерентности в нормальном металле при $T = T_c$ [28]. На этом же графике приведена зависимость $J_c(T)$ теории [28] для 2a = 0, совпадающая с зависимостью Кулика-Омельянчука (КО) для чистых коротких микромостиков [30] и с зависимостью из работы [7] для чистых коротких S-N-S-переходов, а также зависимость $J_c(T)$ Амбегаокара-Баратова (АВ) для туннельных контактов [31]. Кардинальное отличие (даже по знаку кривизны) экспериментальной зависимости $J_{c}(T)$ от зависимости АВ является дополнительным подтверждением того, что в исследованном образце реализуется контакт с непосредственной проводимостью. В работе [32] приведена величина $\xi_N \sim 50 \,\text{\AA}$ для межкристаллитных границ в Y-Ba-Cu-O. Используя эту величину, находим оценочное значение протяженности межкристаллитной границы ~ 15-20 Å. Это значение близко к величине $2a_2 = 10$ Å, полученной из обработки ВАХ (ясно, что при последовательном соединении двух переходов критический ток будет определяться "наихудшим" из них, т.е. с большей протяженностью, поскольку в большинстве теорий $J_c \sim \exp(-2a)$ [7,11,20,28,29]). Отметим, что вблизи Тс наблюдается расхождение эксперимента и теории. Экспериментальная зависимость критического тока становится квадратичной: $J_c \sim (1 - T/T_c)^2$. Такое поведение вблизи Т_с наблюдалось многими авторами на пленочных ВТСП-структурах [25,27,32], точечных ВТСП-контактах [33] и на объемных ВТСПполикристаллах [24,26] и неоднократно обсуждалось. Можно указать как минимум две причины такого поведения: малая длина когерентности ВТСП ведет к редуцированию парного потенциала на S-N-интерфейсе, и как следствие функция $J_c(T)$ становится квадратичной, а не



Рис. 4. Зависимость нормировочного критического тока $J_c(T)/J_c(0)$ от температуры. Точки — эксперимент, сплошные линии — теоретические кривые: AB — зависимость Амбегаокара–Баратова [31], KO — зависимость Кулика–Омельянчука [30], K — зависимость Куприянова [28].

линейной $(1 - T/T_c)$ [34]; тепловые флуктуации вблизи T_c также трансформируют зависимость $J_c(T)$ [35,36].

Таким образом, в данной работе показано, что в рамках теории [15] на основе андреевского отражения можно вполне удовлетворительно описать температурную эволюцию ВАХ с гистерезисной особенностью на переходах, образованных "естественными" границами в поликристаллическом ВТСП. Такое описание оказалось возможным в рамках модели последовательно соединенных контактов металлического характера с различными эффективными протяженностями, а существование гистерезиса и его вид определяются соотношением числа "длинных" и "коротких" межкристаллитных границ в исследуемом поликристаллическом ВТСП.

Отметим, что материалы, обладающие ВАХ с резким переходом от низкого к высокому дифференциальному сопротивлению (т.е. обладающие широким, хорошо выраженным гистерезисом), перспективны для использования в ограничителях тока короткого замыкания [37,38].

Список литературы

- В.М. Свистунов, В.Ю. Таренков, А.И. Дьяченко, И. Хатта. Письма в ЖЭТФ 71, 7, 418 (2000).
- [2] D.E. McCumber. J. Appl. Phys. 39, 7, 3113 (1968).
- [3] R.G. Seed, C. Vittoria, A. Widom. J. Appl. Phys. 75, 12, 8195 (1994).
- [4] K. Saitoh, I. Ishimaru, H. Fuke, Y. Enomoto. Jpn. J. Appl. Phys. 36, 34, L272 (1997).
- [5] L.A.A. Pereira, R. Nicolsky. Physica C282-287, 2411 (1997).
- [6] L.A.A. Pereira, A.M. Luiz, R. Nicolsky. Physica C282-287, 1529 (1997).
- [7] U. Gunsenheimer, U. Schüssler, R. Kümmel. Phys. Rev. B49, 9, 6111 (1994).
- [8] С.Н. Артеменко, А.Ф. Волков, А.В. Зайцев. ЖЭТФ 76, 5, 1816 (1979).
- [9] А.В. Зайцев. ЖЭТФ 78, 1, 221 (1980).
- [10] G.E. Blonder, M. Tinkham, T.M.K. Klapwijk. Phys. Rev. B25, 7, 4515 (1982).
- [11] K.K.Likharev. Rev. Mod. Phys. 51, 1, 101 (1979).
- [12] A.F. Volkov, T.M. Klapwijk. Phys. Lett. A168, 217 (1992).
- [13] U. Gunsenheimer, A.D. Zaikin. Phys. Rev. B50, 9, 6317 (1994).
- [14] E.V. Bezuglyi, E.N. Bratus', V.S. Shumeiko, G. Wendin, H. Takayanagi. Phys. Rev. B62, 21, 14439 (2000).
- [15] R. Kümmel, U. Gunsenheimer, R. Nicolsky. Phys. Rev. B42, 7, 3992 (1990).
- [16] R. Nicolsky. Cryogenics 29, 3, 388 (1989).
- [17] T.P. Devereaux, P. Fulde. Phys. Rev. B47, 21, 14638 (1993).
- [18] M.I. Petrov, D.A. Balaev, D.M. Gohfeld, S.V. Ospishchev, K.A. Shaihutdinov, K.S. Aleksandrov. Physica C314, 51 (1999).
- [19] W. Scocpol. M.R. Beasley, M. Tinkham. J. Appl. Phys. 45, 9, 4054 (1974).
- [20] А. Бароне, Дж. Патерно. Эффект Джозефсона. Мир, М. (1984). 639 с.
- [21] H. Plehn, Q.-J. Wacker, R. Kümmel. Phys. Rev. B49, 17, 12140 (1994).
- [22] А.А. Веревкин, В.А. Ильин, В.С. Эткин. СФХТ **2**, *7*, 128 (1989).

- [23] Л.П. Горьков, Н.Б. Копнин. УФН 156, 1, 117 (1988).
- [24] M.I. Petrov, D.A. Balaev, B.P. Khrustalev, K.S. Aleksandrov. Physica C235–240, 3043 (1994).
- [25] J. Manhart, P. Chaudhary, D. Dimos, C.C. Tsuei, T.R. McGuire. Phys. Rev. Lett. 61, 21, 2476 (1988).
- [26] M.I. Petrov, D.A. Balaev, S.V. Ospishchev, K.A. Shaihutdinov, B.P. Khrustalev, K.S. Aleksandrov. Phys. Lett. A237, 85 (1997).
- [27] S. Benacka, V. Strbik, S. Chromik, R. Adam, M. Darula, S. Gazi. ΦΗΤ 24, 7, 621 (1998).
- [28] М.Ю. Куприянов. ФНТ 7, 6, 700 (1981).
- [29] A. Furusaki, M. Tsukada. Phys. Rev. B43, 13, 10164 (1991).
- [30] И.О. Кулик, А.Н. Омельянук. ФНТ 3, 7, 945 (1977).
- [31] V. Ambegaokar, A. Baratoff. Phys. Rev. Lett. 10, 11, 486 (1963).
- [32] J.W.C. De Vries, G.M. Stolmann, M.A.M. Gijs. Physica C157, 406 (1989).
- [33] Б.А. Аминов, Н.Б. Брандт, Н.М. Тху, Я.Г. Пономарев, М.В. Судаков, А.И. Акимов, Л. Рошта, Л.М. Фишер. СФХТ 2, 1, 93 (1989).
- [34] D. Deutscher, K.A. Müller. Phys. Rev. Lett. 59, 15, 1745 (1987).
- [35] V. Ambegaokar, B.J. Galperin. Phys. Rev. Lett. 22, 25, 1364 (1969).
- [36] М.И. Петров, Д.А. Балаев, К.А. Шайхутдинов, К.С. Александров. ФТТ 41, 6, 969 (1999).
- [37] М.И. Петров, Д.А. Балаев, В.И. Кирко, С.Г. Овчинников. ЖТФ 68, 10, 129 (1998).
- [38] M.I. Petrov, S.N. Krivomazov, B.P. Khrustalev, K.S. Aleksandrov. Solid State Commun. 82, 6, 453 (1992).